

2007年3月期 決算説明会（2007年5月7日実施）

代表取締役社長 川村 誠スピーチ

<スライド1：将来予想に関する注意事項>

なお、本日の説明内容につきましては、こちらの「将来予想に関する注意事項」にご留意願います。

<スライド2：2008年3月期 連結業績予想（1）>

こちらのスライドは今期の業績予想です。今期は、当期純利益を除き、増収増益を予想しております。連結売上高は、過去最高の1兆3,300億円、前期比3.6%の増収となる見通しで、営業利益は前期比11.8%増益の1,510億円、営業利益率は11.4%を予想しております。このスライドの中ほどより下に減価償却費の予想を記載しておりますが、今期は、減価償却制度の変更もあり、減価償却費が90億円程度増加する見通しですが、今期は2桁の営業利益の成長を達成できる見通しです。

また、税引前当期純利益は6.0%増益の1,660億円、税引前当期純利益率は12.5%を予想しております。なお、当期純利益ですが、前期は移転価格課税の更正処分の一部取り消しによる還付税額や、京セラリーシング売却に伴う利益など、合計で約95億円の一時的な利益を計上しましたが、今期はこのような利益を予定しておりませんので、前期比3.3%のわずかながら減益の1,030億円、当期純利益率7.7%となる見通しです。

<スライド3：事業利益率の推移

— 2004年3月期～2008年3月期（予想）—>

このスライドは、2004年3月期から今期予想までの事業利益率の推移です。赤のラインが京セラグループ連結の利益率の推移です。また、白のラインで部品事業を、ピンクのラインで機器事業を示しております。

当社は京セラグループ連結で15%以上の税引前当期純利益率を経営目標とし

ておりますが、部品事業においては、前期に既にこの目標数値を達成しており、今期は前期の事業利益率をさらに上回る16.7%を予想しております。また、機器事業の事業利益率は、通信機器関連事業の利益率改善を主因に、7.6%となる見通しです。

前期に引き続き、部品事業、機器事業の増益を予想しており、今期は税引前当期純利益で3期連続の増益を予想しております。今期予想の税引前当期純利益率12.5%は、来期以降、目標の15%を視野に捉えることが出来る水準になってまいりました。

<スライド4：2008年3月期 連結業績予想（2）>

こちらのスライドに、今期の業績予想の前提となります為替レートを記載しております。今期の平均為替レートは、ドルで110円、ユーロで150円を想定しております。2007年3月期に比べ、ドルで7円の円高、ユーロは前期と同じと予想しており、現状の為替水準よりも円高を想定しています。前期2007年3月期と比較しますと、為替レート変動による影響額は、売上高に対し約340億円、税引前当期純利益に対し約70億円のデメリットが生じるものと予想しております。

<スライド5：2008年3月期事業環境見通し>

それでは、今期の事業環境見通しについてご説明申し上げます。

こちらのスライドに、当社が予想しております主要電子機器の生産台数見通しを示しております。

携帯電話端末やパーソナルコンピュータ（パソコン）、デジタルテレビなどの主要電子機器の2007年暦年の生産台数は、2006年暦年に比べ、いずれも増加する見通しです。

携帯電話端末やパソコンは、買換え需要や新興市場での普及が、デジタルテレビは液晶やプラズマテレビなどの生産台数の伸びが見込まれます。

セットの生産増加に伴い、部品に対して旺盛な需要が見込まれることから、部品単価の下落も緩やかな下落にとどまると予想しております。セラミックコンデンサを例に取りますと、セラミックコンデンサの平均で、前期末に比較し、年間で

10%前後の下落にとどまる見通しです。

現在、携帯電話端末市場は、端末メーカーによって生産状況にバラツキがでております。しかし、当社は特定顧客へ依存しておらず、グローバルに当社部品を端末メーカーへ納入しているため、携帯電話端末市場全体の好需要を捉えられると考えております。

＜スライド6：2008年3月期 事業セグメント別売上高・

税引前当期純利益予想－前期比増減額－＞

こちらのスライドは、各事業セグメントの売上高及び税引前利益の通期予想と前期実績とを比較し、その増加金額を示しております。上段が売上高、下段が税引前利益の増加額です。

売上高は、部品事業では、ファインセラミック応用品関連事業や半導体部品関連事業などが増収増益をけん引する見通しです。また、機器事業においては、通信機器関連事業がKWCやPHS関連事業の収益改善を主因に、大幅に増収増益となる見通しです。

＜スライド7：2008年3月期 半導体部品関連事業の取組み＞

まず、半導体部品関連事業の取組みについてご説明申し上げます。このセグメントは、部品事業の中でも、過去から当社グループの中心事業で、全社の収益に貢献している事業であり、既に高収益事業のひとつではありますが、さらに持続的に収益を拡大していくための課題は、セラミックパッケージのシェアアップです。現在高いシェアを有する表面実装（SMD）パッケージやCCD/CMOS用パッケージなどにおいて、一層のコストダウンと新製品開発を進め、さらなるシェアアップを図ってまいります。

さらに、京セラグループは、技術開発や量産技術などにおいてセラミックパッケージのマーケットリーダーである優位性を活かした事業展開を進めてまいります。継続的に市場の拡大が見込まれる無線通信市場向けに、高周波に対応した電子デバイス用LTCC（低温焼成セラミック）基板などの拡販に努めてまいります。

セラミックパッケージ事業の展開に加えて、中期的な視点に立ち、京セラグループの半導体部品事業の成長を支える有機パッケージについては、綾部工場でのゲーム機用有機パッケージの量産開始に取り組んでおります。現在、同工場では試作量産を開始しており、下期から量産を開始すべく準備を進め、この事業での下期からの黒字を目指してまいります。

<スライド8：2008年3月期 ソーラーエネルギー事業の取組み>

次に、ソーラーエネルギー事業の取組みについてご説明申し上げます。

こちらは、当社ソーラーセルの生産量のグラフです。世界的な環境意識の高まりとともに、当社の生産量も増加してまいりました。2004年3月期から2007年3月期にかけて、生産量は年率30%の伸びを示しておりますが、前期は、2006年3月期に比べ、わずか5%ほどの伸びにとどまりました。この要因は原材料の調達不足にあるということは、既に皆様、ご存知のことと思います。

しかし、今期下期には、当社の生産計画に見合った原材料確保の体制が整い、生産量を増加させ、今期は前期に比べ約20%増の200メガワットに生産量を拡大する予定です。これにより、収益の増加と利益率の向上を図ります。

また、引き続き180 μ m（ミクロン）セルの生産比率をアップさせ、一層のコストダウンを図ってまいります。当社には30年以上の技術の蓄積があり、この高い生産技術を活かし、生産性の向上を進めることで、中国などの新規参入メーカーとの品質・価格競争にも打ち勝つことが出来るものと考えております。

<スライド9：2008年3月期 電子デバイス関連事業の取組み>

続きまして、現在、部品事業の中で最も高い売上高を占める電子デバイス関連事業の収益拡大のための取組みについてご説明申し上げます。

主要電子機器の生産台数の伸びに加え、高機能化による各機器の部品員数の増加や高付加価値部品の需要増が見込まれ、今期も部品市場は好調に推移することが予想されます。当社はこのような環境のもとで、小型大容量コンデンサや民生用水晶デバイスなど、より高付加価値な部品の売上拡大を図ります。

また、当社電子デバイス関連事業の最大の優位性は、多くの電子デバイス技術をグループ内に有していることです。この強み、つまりグループシナジーを活かし

た製品展開を行ってまいります。具体的には、A V Xとのシナジーにより開発、量産いたしました低インダクタンスコンデンサを前期より市場投入しております。今後も、A V Xに限らず、京セラキンセキや京セラエルコなど一層のグループシナジーを追求し、総合電子デバイスメーカーとして、幅広い製品展開を進めます。

<スライド10：2008年3月期 通信機器関連事業の取組み>

それでは、今期、収益の大幅な伸びを予定しています通信機器関連事業についてご説明申し上げます。

このセグメントのひとつ目の取組みは、新モデルの拡販による、携帯電話端末のシェアアップです。国内の携帯電話市場の成長率は鈍化しており、今後、この市場で確固たる市場ポジションを獲得し、事業を伸ばすためには、機能性だけでなくデザインなどに特長のあるモデルを投入し、ヒット商品を生み出すことが不可欠となっています。前期、当社は「W44K」という薄型端末を市場投入し、これが大ヒット商品となりました。この「W44K」モデルの成功に見られるように、当社のデザイン開発力や製品企画力は、業界をリードする地位にあります。今期も引き続き、機能性とデザイン性に優れた携帯電話端末の投入を図り、a uでのシェアアップを目指します。

ふたつ目は、国内P H S端末のシェアアップです。前期までの中国市場を中心とした事業展開を改め、今期は国内P H S市場に開発リソースをかけ、P H S事業の収益改善を図ります。新製品のコンスタントな市場投入と、高機能モデルからシンプルモデルまで幅広い製品投入を進めることで、国内P H S事業でのシェアアップを図ってまいります。

また、通信機器関連事業の収益改善・拡大に欠かせない取組みとして「製造力」の強化があります。通信機器関連事業には、なお一層の原材料コストの削減など、改善の余地がまだあると考えており、「アメーバ経営」のさらなる浸透を図ってまいります。部材のコストダウンに加え、生産性の改善やリードタイムの短縮などにより、「製造力」、つまり「現場力」を強化してまいります。

それでは説明の最後に、持続的な企業成長を図っていくために今期、取組んでまいります取組みについてご説明申し上げます。

<スライド 11：「新たな創造」によりさらなる成長を目指す>

前期は、「アメーバ経営」への原点回帰”を最重要課題とし、現場の活力である「現場力」と、目標を確実に達成する「実現力」を高めることに重点的に取り組んでまいりました。この“「アメーバ経営」への原点回帰”により、「現場力」、「実現力」の強化が図られ、その効果が業績に現れたと考えております。

この“「アメーバ経営」への原点回帰”に加え今期は、戦略事業に対する“攻め”の経営を推進してまいります。

<スライド 12：持続的業績拡大を目指して>

まず、ソーラーエネルギー事業の強化です。今期より、ソーラーセルとモジュールの生産拡大を進めます。2007年3月期は170メガワットの生産量でしたが、2011年3月期には、500メガワットを目標に、今期下期より生産能力を拡大し、早急に売上高1,000億円を目指してまいります。

次に、セラミックコンデンサの能力増強とシェアアップを図ります。2007年12月完成予定で鹿児島国分工場内に新建屋を設立し、今期末の稼働を目指しております。2009年3月期のフル稼働時には、セラミックコンデンサの国内生産能力は、現在の2倍になる予定です。

続きまして、半導体部品関連事業の新市場開拓です。すでに量産を開始しておりますが、LTCC基板などのセラミックパッケージの拡販を進めるとともに、ゲーム機用有機パッケージやSiP有機基板などの生産量増加を図り、総合パッケージサプライヤーとして、事業拡大を進めます。

最後に情報機器関連事業の事業拡大です。市場はたいへん厳しい競争状況にありますが、当社は、「エコシス」コンセプトという差別化戦略をベースに収益の拡大に努めます。特に環境意識の高い欧州地域では、この長寿命でエコロジー、エコノミーというコンセプトが受け入れられています。このように欧州では、販売拡大を支える基盤が整っており、今後は日本や米国市場でも「エコシス」コンセプトの認知度を高め、カラー機の売上増を図るとともに、東欧やBRICsなどへのモノクロ機の拡販を進めてまいります。

<スライド 13：設備投資額の推移>

当社は、今期の業績予想の達成を図るとともに、ただいまご説明させていただきましたソーラーエネルギー事業やセラミックコンデンサ事業で能力増強のための大型設備投資を実施します。こちらのグラフは設備投資額の推移を示しておりますが、今期の設備投資額は、2期前、2006年3月期とほぼ同水準になる見通しです。

今期、大型設備投資を予定しておりますソーラーエネルギー事業やセラミックコンデンサ事業は、いずれも今後の市場拡大が見込まれる事業であり、能力増強を行うことで、より強固なマーケットポジションの確立やシェアアップを狙える事業であると考えております。今期の大型設備投資により、重点事業での売上拡大と利益率向上を図り、これらの事業が京セラグループの業績拡大のキードライバーとなると考えています。

以 上